

2020年中国封测行业分析报告- 市场规模现状与发展趋势分析

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国封测行业分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/471784471784.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

半导体生产流程由晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和封装后测试组成。半导体封装测试是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。

半导体产业链概况 资料来源：公开资料整理

目前封装技术正逐渐从传统的引线框架、引线键合向倒装芯片（FC）、硅通孔（TSV）、嵌入式封装（ED）、扇入（Fan-In）/扇出（Fan-Out）型晶圆级封装、系统级封装（SiP）等先进封装技术演进。芯片的尺寸继续缩小，引脚数量增加，集成度持续提升。而针对不同的封装有不同的工艺流程，并且在封装中和封装后都需要进行相关测试保证产品质量。

半导体先进封装系列 资料来源：公开资料整理

半导体下游终端产品种类众多，不同类型的产品适用于不同的封装形式。

封装应用领域及对应的封装形式

产品名称

应用类型

采用的封装形式

手提电脑、平板电脑、显示屏、硬盘等

计算机类

SOP、SOT、QFPLQFP、QFNDFN.CSP、TSV

光机电一体化、工业电子整流器、变频器、机器人等

工业自动化系统

SSOP、QFP/LOFP、TSSOP

手机、电缆调制解调器、网卡等

通讯电信类

SOP.SOT.QFPLQFP、TSSOP、BGA、QFNDFN、CSP、TSV

调光灯、节能灯

照明电路

SSOP、QFNDFN、BGA

电冰箱、数码相机、机顶盒、电吹风、微波炉、吸尘器、电度表

消费电子类

TO、DIP、BGA、SOP、QFPLQFP、QFNDFN、TSSOP

汽车整流器、汽车音响、汽车空调、ABS控制器、气囊和车内巡航控制以及导航系统

汽车电子类

SOT、QFPLQFP、TSSOP资料来源：公开资料整理

据中国半导体行业协会封装分会的统计，截至2019年年底，我国有一定规模的封装测试企业共有87家，其中本土企业或内资控股企业有29家，年生产能力1464亿块。封装测试

行业已形成较大规模，主要厂商呈现外商独资、中外合资和内资三足鼎立的格局。

除了三大封测上市公司外，还有晶方科技、太极实业、深科技、中电广通、华隆微电、确安科技、华岭股份、利扬芯片，毛利率也普遍在15-20%，可以看出封测行业的竞争激烈程度。

目前，中国封测业分布从集中于长三角、珠三角、环渤海地区，已扩散到中西部地区，形成四足鼎立的格局，以新潮科技等为代表的国内龙头企业在全球的市占率不断提升。

2019年我国封测行业企业集中度 数据来源：观研天下数据中心整理

半导体封测已逐渐成为我国半导体的优势环节，因此对比其他环节来看，我国厂商在封测领域占比更高，而目前技术也达到了国际领先水平。

目前，我国国产封装测试企业已形成一定竞争力。国际先进技术的进入带动我国封测技术的不断提高，长电科技、华天科技、通富微电等内资企业已进入全球封测企业前20名，并通过海外收购或兼并重组等方式不断参与到国际竞争中，如长电科技于2019联合国家大基金、芯电半导体收购了全球第4大封装测试企业星科金朋体实力大幅提升；华天科技于2019年完成对美国Flip Chip International公司100%股权收购，进一步提高了其在国际市场的竞争能力；通富微电于2019完成了对超威半导体苏州公司及AMD槟城各85%股权的收购，先进封装产能得到大幅提升。

即将到来的物联网和人工智能时代，创新科技产品的诞生将给集成电路行业带来新的机会。目前，物联网、5G、医疗、人工智能等新兴产业将成为行业新的市场推动力，广阔的市场空间给行业带来了新的发展机遇，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内集成电路封测公司将会出现发展的新契机。而行业的发展需要投资的促进，集成电路作为未来发展是我国大力鼓励的防线，未来集成电路行业的投资增速将保持高速增长。根据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2019年中国集成电路产业销售收入中封测业销售收入占总值的31.1%，这表明集成电路封测行业在整个集成电路行业中占有重要地位。预计从2020年到2026年，国内集成电路封测行业投资将保持稳定增长，具体如下：

2020-2026年我国封测行业投资增速预测 数据来源：观研天下数据中心整理

观研报告网发布的《2021年中国封测行业分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行

业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及**等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 芯片封测行业相关概述

第一节 半导体的定义和分类

- 一、半导体的定义
- 二、半导体的分类
- 三、半导体的应用

第二节 半导体产业链分析

- 一、半导体产业链结构
- 二、半导体产业链流程
- 三、半导体产业链转移

第三节 芯片封测相关介绍

- 一、芯片封测概念界定
- 二、芯片封装基本介绍
- 三、芯片测试基本原理
- 四、芯片测试主要分类
- 五、芯片封测受益的逻辑

第二章 2017-2021年国际芯片封测行业发展状况及经验借鉴

第一节 全球芯片封测行业发展分析

- 一、全球半导体市场发展现状
- 二、全球封测市场竞争格局
- 三、全球封装技术演进方向
- 四、全球封测产业驱动力分析

第二节 日本芯片封测行业发展分析

- 一、半导体市场发展现状
- 二、半导体市场发展规模
- 三、芯片封测企业发展状况
- 四、芯片封测发展经验借鉴

第三节 中国台湾芯片封测行业发展分析

- 一、芯片封测市场规模分析
- 二、芯片封测企业盈利状况
- 三、芯片封装技术研发进展
- 四、芯片封测发展经验借鉴

第四节 其他国家芯片封测行业发展分析

- 一、美国
- 二、韩国

第三章 2017-2021年中国芯片封测行业发展环境分析

第一节 政策环境

- 一、智能制造发展战略
- 二、集成电路相关政策
- 三、中国制造支持政策
- 四、智能传感器行动指南
- 五、产业投资基金支持

第二节 经济环境

- 一、宏观经济发展现状
- 二、工业经济运行状况
- 三、经济转型升级态势
- 四、未来经济发展展望

第三节 社会环境

- 一、互联网运行状况
- 二、可穿戴设备普及
- 三、研发经费投入增长
- 四、科技人才队伍壮大

第四节 产业环境

- 一、集成电路产业链
- 二、产业销售规模
- 三、产品产量规模

四、区域分布情况

五、设备发展状况

第四章 2017-2021年中国芯片封测行业发展全面分析

第一节 中国芯片封测行业发展综述

一、行业主管部门

二、行业发展特征

三、行业生命周期

四、主要上下游行业

五、制约因素分析

六、行业利润空间

第二节 2017-2021年中国芯片封测行业运行状况

一、市场规模分析

二、主要产品分析

三、企业类型分析

四、企业市场份额

五、区域分布占比

第三节 中国芯片封测行业技术分析

一、技术发展阶段

二、行业技术水平

三、产品技术特点

第四节 中国芯片封测行业竞争状况分析

一、行业重要地位

二、国内市场优势

三、核心竞争要素

四、行业竞争格局

五、竞争力提升策略

第五节 中国芯片封测行业协同创新发展模式分析

一、华进模式

二、中芯长电模式

三、协同设计模式

四、联合体模式

五、产学研用协同模式

第五章 2017-2021年中国先进封装技术发展分析

第一节 先进封装技术发展概述

- 一、一般微电子封装层级
- 二、先进封装影响意义
- 三、先进封装发展优势
- 四、先进封装技术类型
- 五、先进封装技术特点

第二节 中国先进封装技术市场发展现状

- 一、先进封装市场规模
- 二、龙头企业研发进展
- 三、晶圆级封装技术发展

第三节 先进封装技术未来发展空间预测

- 一、先进封装前景展望
- 二、先进封装发展趋势
- 三、先进封装发展战略

第六章 2017-2021年中国芯片封测行业不同类型市场发展分析

第一节 存储芯片封测行业

- 一、行业基本介绍
- 二、行业发展现状
- 三、企业发展优势
- 四、项目投产动态

第二节 逻辑芯片封测行业

- 一、行业基本介绍
- 二、行业发展现状
- 三、市场发展潜力

第七章 2017-2021年中国芯片封测行业上游市场发展分析

第一节 2017-2021年封装测试材料市场发展分析

- 一、封装材料基本介绍
- 二、封装材料市场规模
- 三、封装材料发展展望

第二节 2017-2021年封装测试设备市场发展分析

- 一、封装测试设备主要类型
- 二、全球封测设备市场规模
- 三、中国封测设备投资状况

四、封装设备促进因素分析

五、封装设备市场发展机遇

第三节 2017-2021年中国芯片封测材料及设备进出口分析

一、塑封树脂

二、自动贴片机

三、塑封机

四、引线键合装置

五、其他装配封装机器及装置

六、测试仪器及装置

第八章 2017-2021年中国芯片封测行业部分区域发展状况分析

第一节 深圳市

一、政策环境分析

二、区域发展现状

三、项目落地状况

第二节 江西省

一、政策环境分析

二、区域发展现状

三、项目落地状况

第三节 苏州市

一、政策环境分析

二、市场规模分析

三、项目落地状况

第四节 徐州市

一、政策环境分析

二、区域发展现状

三、项目落地状况

第五节 无锡市

一、政策环境分析

二、区域发展现状

三、项目落地状况

第九章 国内外芯片封测行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 艾马克技术（Amkor Technology, Inc.）

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第二节 日月光半导体制造股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第三节 京元电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第四节 江苏长电科技股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第五节 天水华天科技股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第六节 通富微电子股份有限公司

一、企业发展简况分析

二、企业产品服务分析

三、企业发展现状分析

四、企业竞争优势分析

第十章 中国芯片封测行业的投资分析

第一节 芯片封测行业投资背景分析

一、行业投资现状

二、行业投资前景

三、行业投资机会

第二节 芯片封测行业投资壁垒

- 一、技术壁垒
- 二、资金壁垒
- 三、生产管理经验壁垒
- 四、客户壁垒
- 五、人才壁垒
- 六、认证壁垒

第三节 芯片封测行业投资风险

- 一、市场竞争风险
- 二、技术进步风险
- 三、人才流失风险
- 四、所得税优惠风险

第四节 芯片封测行业投资建议

- 一、行业投资建议
- 二、行业竞争策略

第十一章 中国芯片封测产业典型项目投资建设案例深度解析

第一节 通信用高密度集成电路及模块封装项目

- 一、项目基本概述
- 二、投资价值分析
- 三、项目建设用地
- 四、资金需求测算
- 五、经济效益分析

第二节 通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目

- 一、项目基本概述
- 二、投资价值分析
- 三、项目建设用地
- 四、资金需求测算
- 五、经济效益分析

第三节 南京集成电路先进封测产业基地项目

- 一、项目基本概述
- 二、项目实施方式
- 三、建设内容规划
- 四、资金需求测算
- 五、项目投资目的

第四节 光电混合集成电路封测生产线建设项目

一、项目基本概述

二、投资价值分析

三、项目实施单位

四、资金需求测算

五、经济效益分析

第五节 先进集成电路封装测试扩产项目

一、项目基本概述

二、项目相关产品

三、投资价值分析

四、资金需求测算

五、经济效益分析

六、项目环保情况

七、项目投资风险

第十二章 2021-2026年中国芯片封测行业发展前景及趋势预测分析

第一节 中国芯片封测行业发展前景展望

一、半导体市场前景展望

二、芯片封装行业发展机遇

三、芯片封装领域需求提升

四、终端应用领域的带动

第二节 中国芯片封测行业发展趋势分析

一、封测企业发展趋势

二、封装技术发展方向

三、封装技术发展趋势

四、封装行业发展方向

第三节 2021-2026年中国芯片封测行业预测分析

图表目录

图表：半导体分类结构图

图表：半导体分类

图表：半导体分类及应用

图表：半导体产业链示意图

图表：半导体上下游产业链

图表：半导体产业转移和产业分工

图表：集成电路产业转移状况

图表：全球主要半导体厂商

图表：现代电子封装包含的四个层次

图表：根据封装材料分类

图表：目前主流市场的两种封装形式

图表：2021年全球封测企业市场份额排名

图表：2017-2021年日本半导体销售额

图表：2021年中国台湾集成电路产值情况

图表：2021年中国台湾集成电路产业链各环节产值情况

图表：2017-2021年中国台湾集成电路产值

图表：2017-2021年韩国半导体产业情况

图表详见报告正文 (GYSYL)

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/471784471784.html>